



股票代號
6525



捷敏股份有限公司
GEM Services, Inc.

法人說明會
2022/03/30



免責聲明

本次法說會所提供之簡報內容包括對於未來狀況之預測與評估之陳述，乃基於公司目前可得資料之概略說明，其涉及風險及不確定性，並可能發生實際結果與預期狀況有重大差異的情形，提醒各位不要依賴這些資訊，另除非法律要求本公司將不負責更新或公告這些預測的結果。

簡報內容

- 公司概况
- 營運概況
- 財務概況
- 未來展望
- Q&A

公司概況

創立

- 成立於1998年

產能

- 65億顆年封測產能

特別技術

- Multi-chip Module (多晶粒模組)
- J-lead Wide Body (內彎腳型封裝)
- Leadless (底部貼焊型)
- Bond-wireless(非鉚線結構):
Flip chip, Cu Clipper

終端應用

- 電腦, 手機, 手持電子產品
- LCD / 電漿顯示器
- 家電產品

員工

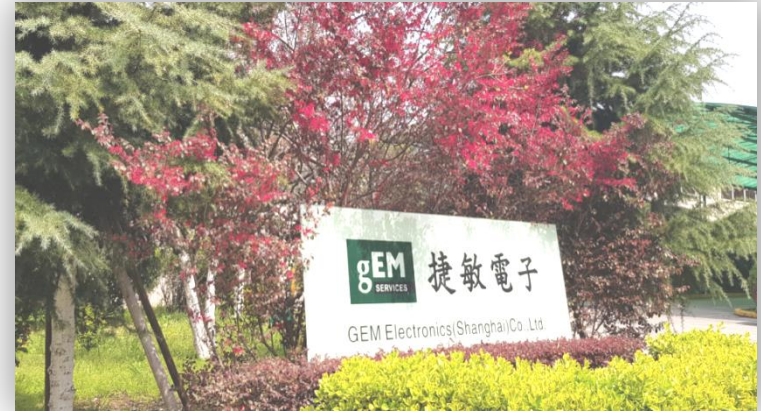
- 員工人數: 1,750+ (技術人員: 500+)

營運據點

- 總部: 台灣新北市中和區

主要股東

- 聯鈞光電股份有限公司 (持股51%)



- 工業電子系統
- 電動車/車載電子

- 上海廠: 中國上海市嘉定區
- 合肥廠: 中國安徽省合肥市



- 土地面積: 19,000 平方公尺 (租賃)
- 建築佔地面積: 15,400 平方公尺
- 樓地板面積: 17,836 平方公尺



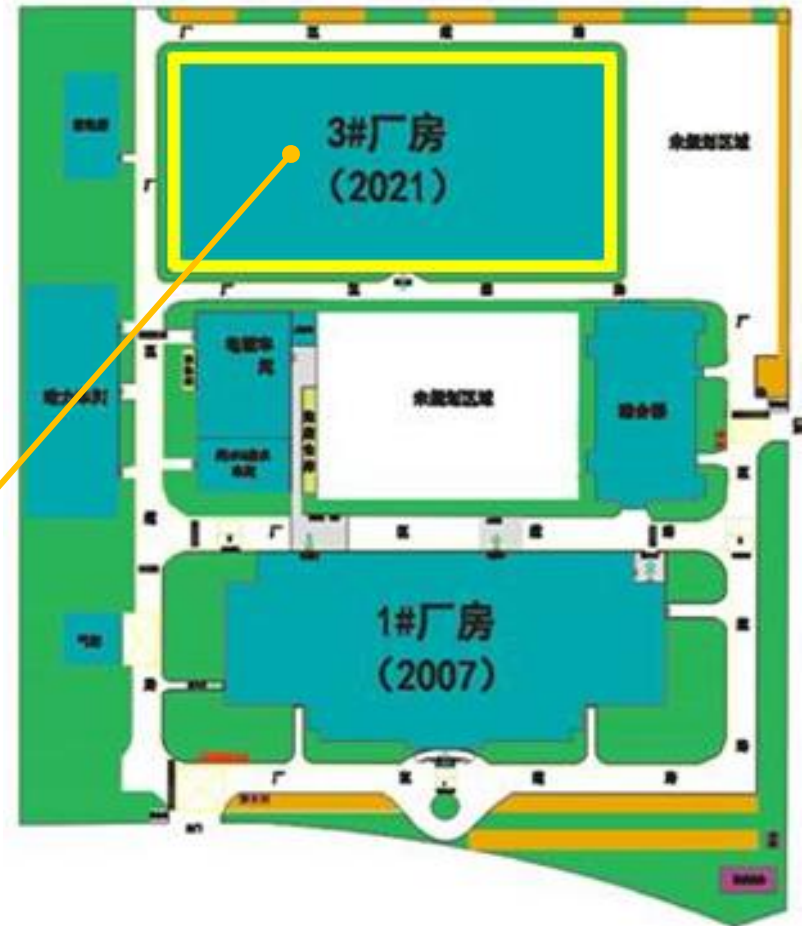
Bd#1

- 土地面積: 69,812平方公尺 (自有)
- 合肥舊廠房 (Bd#1)
 建築佔地面積: 17,920平方公尺
 樓地板面積: 28,588平方公尺
- 合肥新廠房 (Bd#3)
 建築佔地面積: +10,368平方公尺
 樓地板面積: +39,096平方公尺



Bd#3

厂区布局图



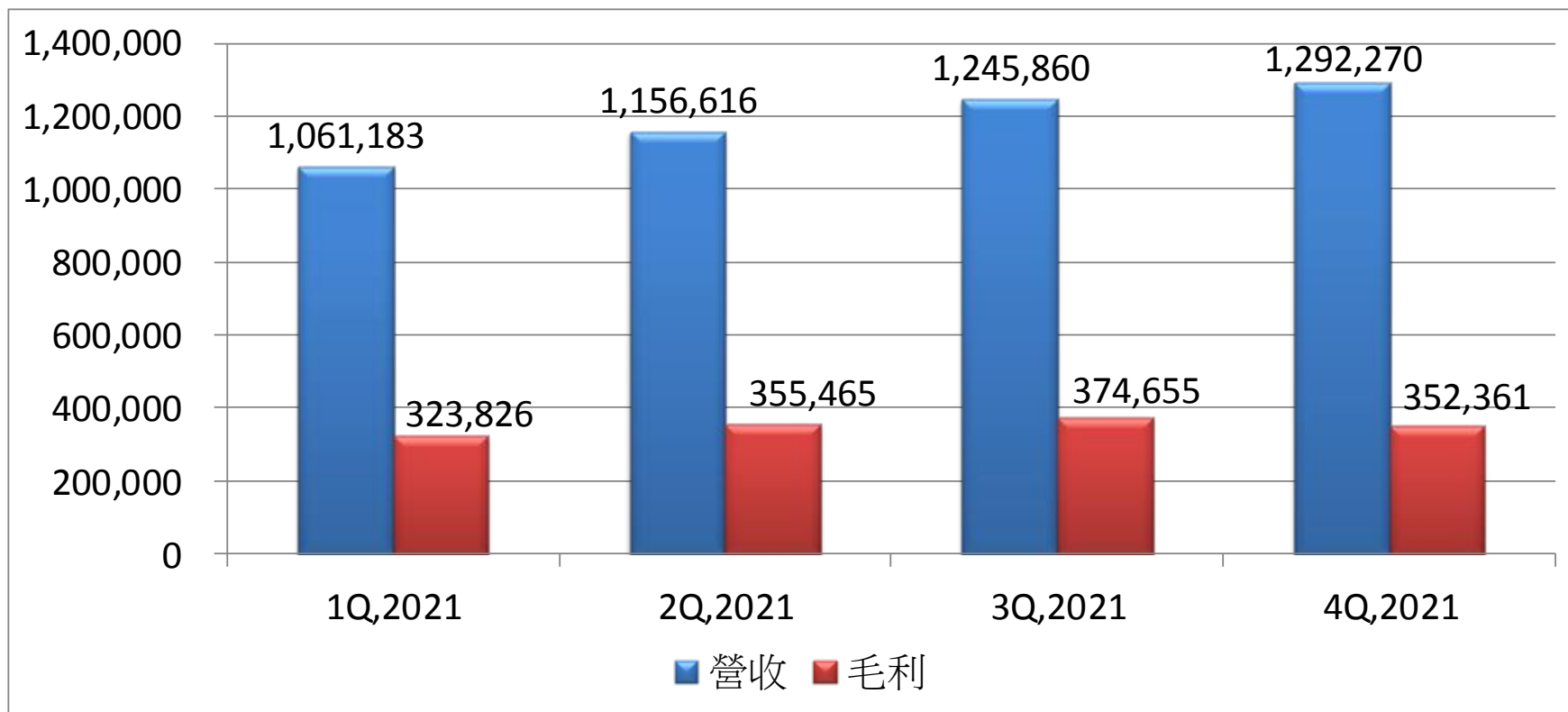
- 提供 高低壓功率金氧半場效電晶體(Power MOSFET)、絕緣柵雙級型電晶體(IGBT)、二極體(Diode)及電源轉換或電源管理 IC (Power Management ICs)、功率模組等之封裝與測試服務
- 主要應用於 通訊、電腦/筆電主機板及周邊產品、家電消費性電子產品, 以及任何需要電力系統供其運轉之車用電子及工業用設備機具應用等



營運概況

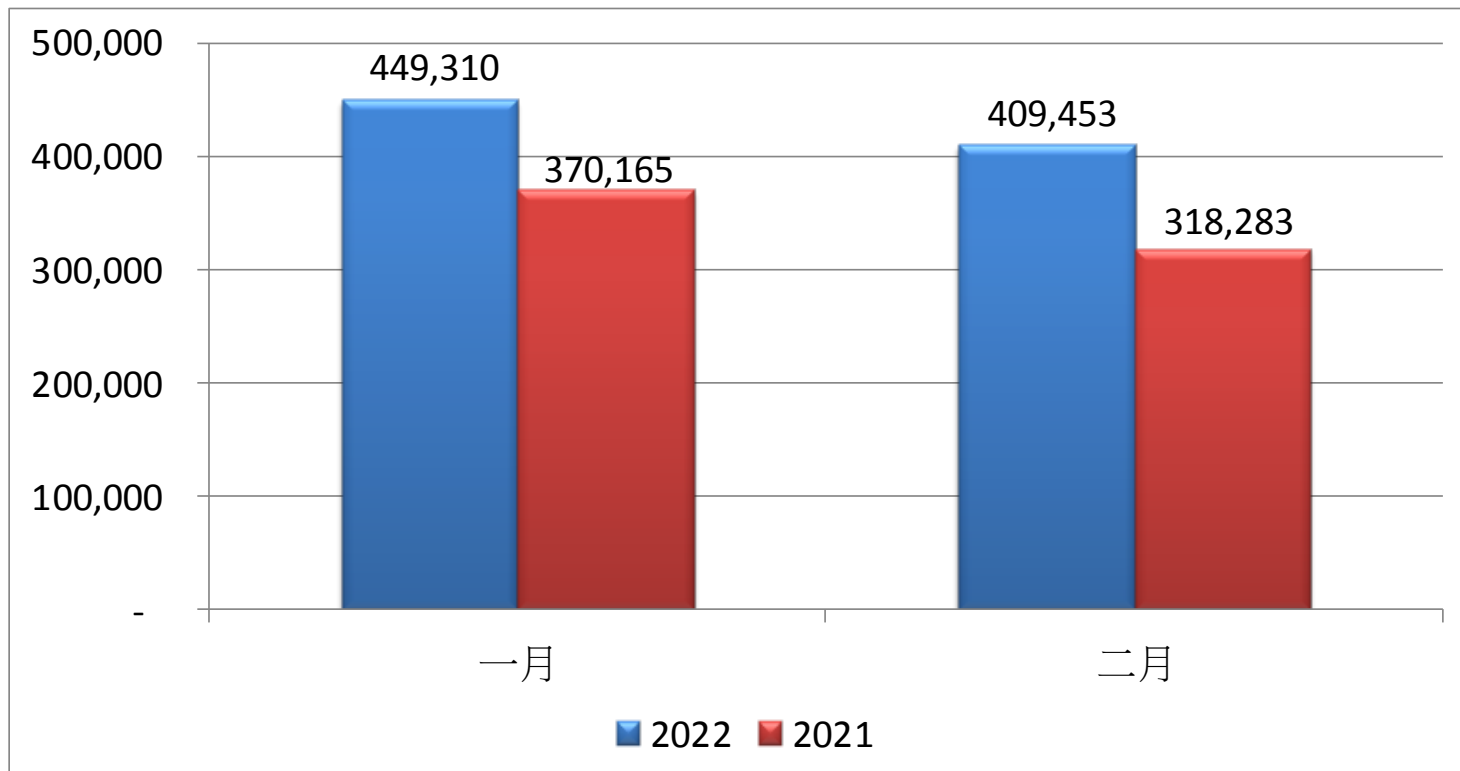
2021年各季合併營收與毛利

新台幣：仟元



2022年各月份合併營收

新台幣：仟元



合併損益表

單位：新台幣仟元

	2020年	2021年				
	合計	第1季	第2季	第3季	第4季	合計
營業收入	3,750,121	1,061,183	1,156,616	1,245,860	1,292,270	4,755,929
營業毛利	1,203,556	323,826	355,465	374,655	352,361	1,406,307
毛利率	32.09%	30.52%	30.73%	30.07%	27.27%	29.57%
營業費用	283,984	74,227	79,116	77,357	89,874	320,574
營業淨利	919,572	249,599	276,349	297,298	262,487	1,085,733
營業淨利率	24.52%	23.52%	23.89%	23.86%	20.31%	22.83%
營業外損益	(59,655)	(11,118)	(33,460)	25,133	(13,541)	(32,986)
稅前淨利	859,917	238,481	242,889	322,431	248,946	1,052,747
所得稅費用	175,256	41,573	46,752	61,680	44,757	194,762
本期淨利	684,661	196,908	196,137	260,751	204,189	857,985
EPS	5.31	1.53	1.52	2.02	1.58	6.65

合併資產負債表

單位：新台幣仟元

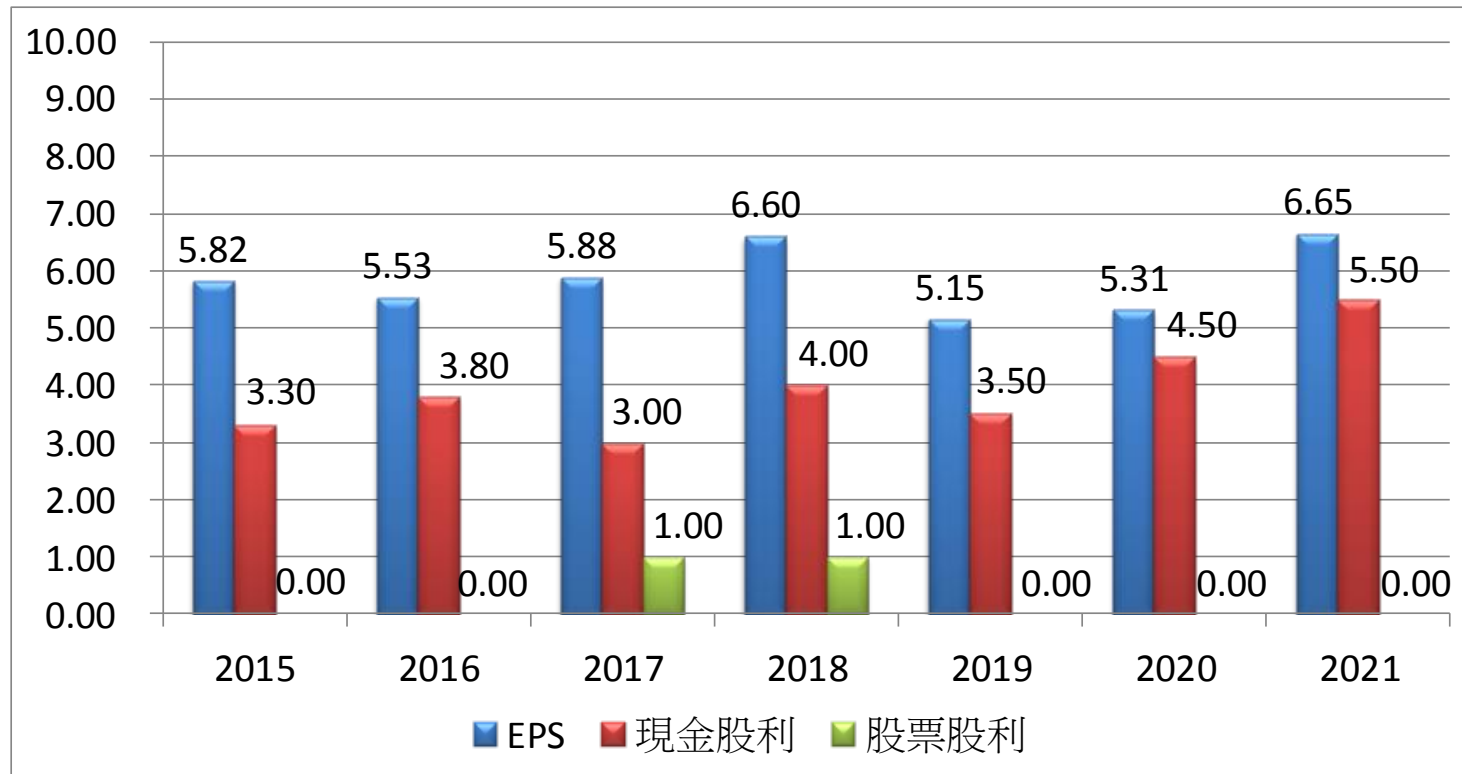
	2020年	2021年			
	第4季	第1季	第2季	第3季	第4季
現金及約當現金	1,877,074	1,951,000	2,216,113	1,469,360	1,652,649
應收款項	782,786	856,944	893,903	956,542	1,015,680
存貨	117,633	179,105	184,739	260,926	288,713
流動資產合計	3,090,109	3,283,776	3,620,515	3,053,269	3,386,237
不動產廠房設備	1,544,622	1,647,258	1,878,980	2,118,395	2,437,086
非流動資產合計	2,061,161	2,209,236	2,448,904	2,893,669	3,291,085
資產總計	5,151,270	5,493,012	6,069,419	5,946,938	6,677,322
應付帳款	583,794	674,676	700,051	800,618	813,644
流動負債合計	1,291,982	2,004,801	2,078,712	1,621,594	2,026,408
非流動負債合計	9,932	12,775	329,192	424,456	521,742
負債總計	1,301,914	2,017,576	2,407,904	2,046,050	2,548,150
普通股股本	1,290,474	1,290,474	1,290,474	1,290,474	1,290,474
資本公積	624,536	624,536	624,536	624,536	624,536
保留盈餘	2,140,002	1,756,197	1,952,334	2,213,085	2,417,274
其他權益	(205,656)	(195,771)	(205,829)	(227,207)	(203,112)
權益總計	3,849,356	3,475,436	3,661,515	3,900,888	4,129,172
負債比率	25.27%	36.73%	39.67%	34.41%	38.16%
流動比率	239.18%	163.80%	174.17%	188.29%	167.11%
本公司每股淨值(元)	29.83	26.93	28.37	30.23	32.00

合併現金流量表

單位：新台幣仟元

	2020年	2021年			
	合計	第1季	前2季	前3季	全年
營業活動淨現金流入(出)	996,853	306,909	603,358	790,852	1,048,230
投資活動淨現金流入(出)	(568,303)	(228,105)	(569,711)	(1,043,647)	(1,176,283)
籌資活動淨現金流入(出)	(483,838)	(7,568)	350,535	(127,487)	(66,967)
匯率變動影響	(79,535)	2,690	(45,143)	(27,432)	(29,405)
現金及約當現金淨增(減)	(134,823)	73,926	339,039	(407,714)	(224,425)
期初現金及約當現金餘額	2,011,897	1,877,074	1,877,074	1,877,074	1,877,074
期末現金及約當現金餘額	1,877,074	1,951,000	2,216,113	1,469,360	1,652,649

單位：新台幣元



- 提升合肥廠產能，目前中低壓及高電壓產品開發與生產並行，另考量產品業務發展方向做計劃性之擴充。
- 持續高附加價值，以及第三代半導體相關產品之開發。
- 5G、工業用及車用產品市場仍是未來發展的重點。

Q&A

謝謝

